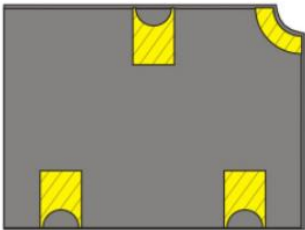


BAT2810~BAT2814 系列硅肖特基单/双二极管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 UB 型金属陶瓷封装，典型重量 0.04g。
 器件具有正向压降小、开关速度快，体积小、重量轻，可靠性高的特点。器件的静电放电敏感度为 3A 级 4000V。



UB 型

2、质量等级及执行标准

G、G+级，Q/RBJ1008，QZJ840611。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	I_{FM1} mA	I_{FM2} (1 μ s 脉冲) A	V_{RWM} V	T_{jm} $^{\circ}\text{C}$	T_{stg} $^{\circ}\text{C}$
BAT2810~BAT2814	70	1	20	150	-65~150

4、主要电特性

主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

参 数		数 值		单 位
符 号	测试条件	最小值	最大值	
V_{BR}	$I_R=10\mu\text{A}$	20	—	V
V_{FM1}	$I_F=1\text{mA}$	—	0.4	V
V_{FM2}	$I_F=35\text{mA}$	—	1	V
I_R	$V_R=15\text{V}$	—	200	nA
C_T	$V_F=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	2	pF

5、外形尺寸

单位为毫米

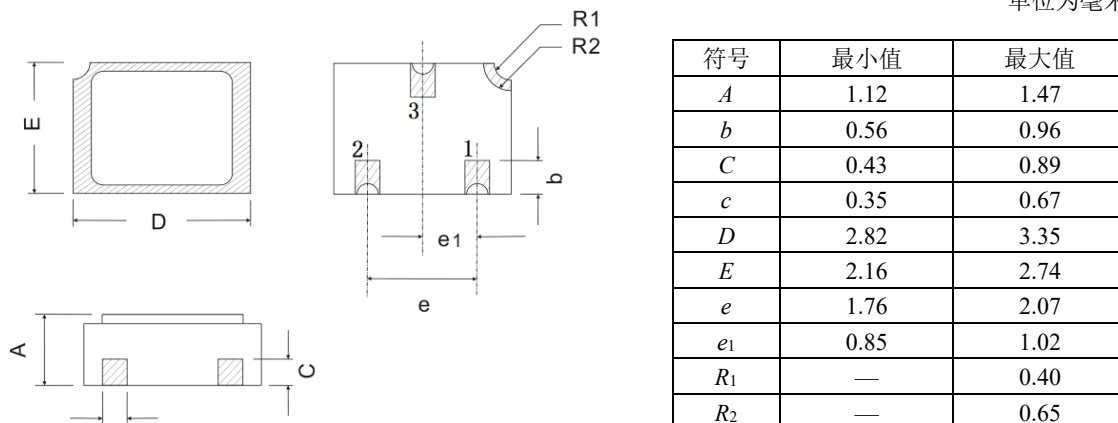


图 1 UB 外形尺寸

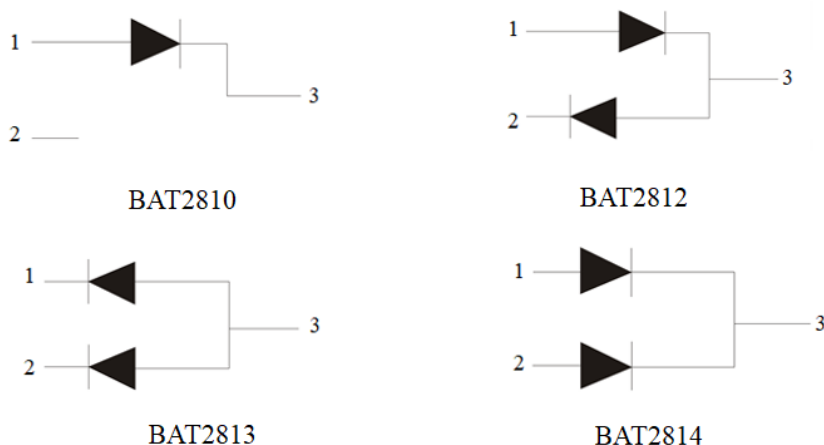


图 2 管芯连接方式

6、使用和维护

6.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大。

UB 型金属陶瓷封装，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，否则易造成陶瓷金属裂缝，影响其密封性。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

6.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。